

木材製品の原材料調達から製造までの環境負荷をLCAで見ると？

東京農工大学名誉教授 服部順昭 氏

本年9月の総会記念シンポジウムでは、林野庁が本年3月に公表した「建築物への木材利用に係る評価ガイドンス」のキーワードであるカーボンニュートラルへの貢献について議論しました。同ガイドンスは、木材利用のさらなる拡大に不可欠なサステナブルファイナンスの導入に向けた重要なフレームワークであり、関係者の注目を集めています。同ガイドンスにおける主要な評価項目のひとつとして、木材製品のLCAが取り上げられています。木材製品の環境負荷の測定方法や考え方は近年大きく進化していることから、2025年1月の月例研究会では、木材製品のサプライチェーンにおける環境負荷に注目し、その最新動向を学ぶ勉強会を企画しました。



講師の服部先生は、日本木材学会会長、日本木材加工技術協会会長を歴任されるとともに、上記の林野庁ガイドンス策定のための委員会座長を務めておられます。木材のLCAに関して、1990年代後半から木質ボード製造までの環境負荷評価に取組まれて以降、木材製品や木造建築の評価に関する多くの研究成果を公表されています。また、港区の「みなとモデル」の設計と運用に深く関わられるなど、LCA研究の社会実装のあり方にも深い知見をお持ちです。

木材利用システム研究会の企業会員の多くは、自社で製造/販売する木材製品の環境負荷の推計と公表を行っていますが、近年では、関係する法制度やルールの変更や強化に伴い、より詳細な情報開示が求められています。当日は、木材製品や木造建築に関わる私たちが、今、知っておくべきこと、考えておくべきことは何なのかを、服部先生の研究成果を踏まえて、皆さんと議論したいと考えています。多くの皆さまの参加をお待ちしております。

～ 記 ～

- 会 場： 2025年1月24日（金）16：30～18：00
- 会 場： 東京大学農学部中島記念ホール【対面開催】
- 主 催： 木材利用システム研究会
- 参 加 費： 会員：無料、非会員：3,000円
賀詞交歓会 5,000円
- 申込期限： 2025年1月21日（月）
- 申込方法： 研究会ホームページ（<https://www.woodforum.jp>）からお申込み下さい。



研究会ホームページ

木材利用システム研究会事務局：（長坂、知念）
〒113-8657 東京都文京区弥生 1-1-1、7号館B棟 438室
東京大学環境材料設計学研究室内
電話：03-5841-7506 FAX：03-5841-0915
メール：info@woodforum.jp